

くまもと3D連携コンソーシアム キックオフ総会

日時 令和5年4月14日(金)
14:00～

会場 熊本大学 黒髪南地区
百周年記念館

熊本県で採択された内閣府事業「令和5年度 地方大学・地域産業創生交付金」による計画「半導体産業の強化及びユーザー産業を含めた新たな産業エコシステムの形成」において実施される研究開発事業への参画や三次元積層実装産業に参入する企業の拡大を目的として「くまもと3D連携コンソーシアム」を設立します。設立に伴い、キックオフ総会を下記要領で開催します。三次元積層実装産業に御興味のある企業様等の御参加をお待ちしております。

会場：熊本大学 黒髪南地区 百周年記念館（地図番号 5 6）
https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_kurokami_2

- 14:00 開会式 挨拶 熊本県 木村 敬 副知事・熊本大学 小川久雄 学長
14:20 基調講演「半導体戦略 ～世界のハイテク産業の中心に位置する熊本～」
リモート講演 講師 東京大学 黒田忠広 教授
15:00 事業説明 ①内閣府事業「地方大学・地域産業創生交付金事業」の説明（熊本県）
②くまもと3D連携コンソーシアムの説明（熊本大学）

15:20 セミナー

- ①「3次元積層実装技術の開発動向ー基礎から応用への展開ー」熊本大学 青柳昌弘 卓越教授
②「FPGA・三次元積層LSIシステムによる知的ロボットシステムの実現に向けて」熊本大学 大川 猛 准教授
③「イメージセンサーの進化」ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 慶児幸秀 技監

- 16:20 閉会
16:25 名刺交換会



開催形式：ハイブリッド

※ご来場の場合、できる限り公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの場合は、入構の手続きが必要です。入構方法や手続きについてはお申込みの方に後日お知らせします。

※リモート聴講は参加者数に制限があります。一社あたり一口でお願い致します。

参加対象 半導体関連企業及び三次元積層実装産業に御興味のある企業・自治体関係者・関係団体・金融機関・半導体関連研究者
(企業や機関等に御所属でない個人の参加は御遠慮ください)

参加申し込み先・問い合わせ先

〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1 熊本大学 熊本創生推進機構

E-mail kumamoto3d@ku-kico.org

TEL：096-342-3247 FAX：096-342-3239

下記のリンクよりお申込み下さい。（右のQRコードを御利用ください）
あるいはメールにてご連絡ください。



■フォームによる申込先

<https://forms.gle/bMiyAqPMtUzTmXtV9>

■メールによる申込先 kumamoto3d@ku-kico.org

メールの場合、以下の項目をお知らせください。
法人名/団体名・所属部署・お名前・連絡先e-mail・
参加形態（現地対面参加またはリモート聴講）

申込締切：4月11日（火）